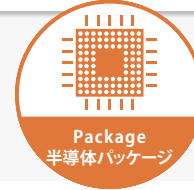


For SMD module low warpage liquid encapsulant SMDモジュール用 低反り液状封止材



Applications 用途

Communication module (MAP, COB) for mobile devices such as notebook PC, digital camera, mobile phone, smartphone, tablet PC.
ノート PC、デジカメ、携帯電話、スマートフォン、タブレット PC 用通信モジュール (MAP、COB)



Enhances process reliability by warpage control and high adhesion (Low warpage of ultrathin module is achieved). Solder flash during mounting reflow has been reduced, resulting in greatly decreasing the defect ratio. Large encapsulation area.

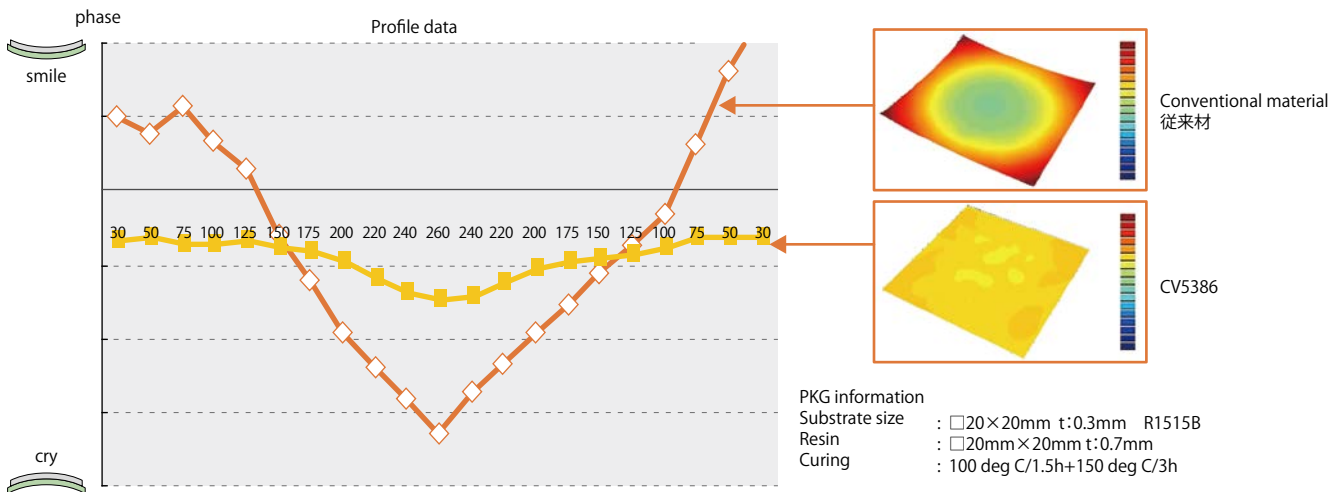
実装リフロー時の半田フラッシュを抑制し、不良率を大幅低減します。超薄型モジュールの低反り化を実現。大面積封止が可能。

Warpage control
反りコントロール

High adhesion
高密着

Reduced solder flash
半田フラッシュ抑制

Warpage behavior : Shadow moire analysis 反り挙動：シャドウモアレ解析



Solder flash after mounting reflow has been reduced (X-ray observation) 実装リフロー後の半田フラッシュ (X線観察)

